



# 展示会「Next Package 2018 秋の陣」を振り返って

Next Package 2018 実行委員  
キッコーマン食品（株） 桑垣 傳美

## 1. Next Package 2018 秋の陣の開催に際して

昨年 2 月の運営委員会において、新規事業企画委員会を立ち上げることが決まりました。これは協会に参加している会員企業・個人にとって、「会員でよかった」と実感できるような事業を行えないか検討するためでした。

これまで日本食品包装協会では研修会、勉強会、見学会、セミナーなど多岐に渡る事業を運営していますが、いままで会員同士の情報交換の機会は少なくそのため交流の場を求める声が多々ありました。そこで新規事業企画委員会では自社の包装材料等を紹介したい包材メーカーと包装材料に関する情報収集を希望する食品メーカーを一同に介した協会独自の展示会を開催することにしました。大きな展示会ではできないじっくりと会員同士がコミュニケーションできるような交流型の展示会にすることをめざしました。

## 2. 展示会の準備

長い歴史を持つ日本食品包装協会にとって、自前で展示会を行うのははじめてのことです。沓掛専務理事と広瀬事務局長を先頭に新規事業企画委員全員が、魅力ある展示会を開催するために知恵を出し合い幾度となく議論を重ねました。開催日時、場所、参加企業募集、スケジュールなど会員の満足度を高めるべく入念に準備をしました。

特に会場を決めることには苦労しました。立地がよくなるべく安価で、希望する日時に空きがある会場はなかなか見つかりませんでした。いくつかの候補会場から、最終的に東京・秋葉原 UDX カンファレンスギャラリーで展示会を開催することに決定しました。

また当協会が次世代に向かって日本の食品包装開発をリードしていく展示会であることを会員に強く意識づけるために、ネーミングにこだわりました。その結果決まった展示会のネーミングが「Next Package 2018 秋の陣」でした。

展示会に出展する企業の募集は 7 月中旬から 8 月末まで行いましたが、募集開始早々に定員に達してしまいました。これは 1 ブース 5 万円と他の展示会に比べて格安であり、参加判断がしやすかったことが要因であったと考えています。

展示方法は基本的に出展各社にお任せしましたが、①展示準備には負担をかけない ②パネルは A1 サイズ (594 mm×841 mm) 2 枚/1 社 ③製品サンプルはテーブル (1500W×600D) に載せられる範囲 という条件で検討していただきました。



### 3. 当日の様子

展示会の検討を始めて焼く9ヵ月後の昨年11月15日に、東京・秋葉原UDXカンファレンスギャラリー（6階カンファレンスルーム）において、「第1回 Next Package 2018 秋の陣」を開催しました。主催は一般社団法人日本食品包装協会。一般社団法人日本包装機械工業会に協賛していただきました。出展した企業は、容器包装材料メーカーが14社（うち海外から1社参加）、食品メーカーが4社（味の素（株）、ハウス食品グループ本社（株）、（株）明治、キッコーマン食品（株））参加しました。

会場は秋葉原駅に近くアクセスがよかったことから当日来場者は200人近くにのぼり、私たち運営者の予想以上に大盛況でした。開会式は10時からを予定していましたが、早くから入り口に大勢の方が待っていたので、予定を5分前倒しにして石川豊実行委員長が開会を宣言し展示会が始まりました。

参加企業各社はポスターや展示品を壁側に配置して、担当者が来場者に熱心に自社製品をアピールしていました。資材メーカーからは新規包装材料の紹介、特に環境対応、機能性包材やインクの紹介の他、一部小袋検査装置の紹介や海外の容器の紹介等もありました（写真1）。また食品会社4社からは最近のパッケージ事例や今後の食品パッケージのめざすところの説明がありました。会場の広さと来場者のバランスが非常によく、各社ともに対面でゆっくり情報交換ができていました。



写真1 包装資材メーカーの説明



写真2 食品メーカーの説明

また展示会の途中には、石谷理事長から「食品包装の未来予測」、沓掛専務理事からは「食品包装の人材育成」と題してミニ講演を行いました（写真3、写真4）。

展示会は17時で終了しましたが、出展者のみなさんにご協力いただき片づけをした後、



ささやかな懇親会を催し、食品企業と包装材料メーカーとの親睦を深めました（写真5）。



写真3 石谷理事長講演の様子



写真4 沓掛専務理事講演の様子



写真5 懇親会

#### 4. 参加いただいた企業と展示内容

展示会に出展いただいた企業と展示内容は下記の通りです。申込みしていただいた順で表記しています。

■押尾産業（株）

レトルト・乳等省令対応の新しいスパウトのご提案

■（株）悠心

包装容器および充填包装機械に加え、ヒートシール状態を観察できる充填サポートシステムのご提案



■DIC (株)

『サステナビリティ』をテーマに、社会課題の要請やお客様のニーズを踏まえたソリューション製品開発およびDICが保有するフィルムの最新技術のご提案

■(株)精工

デジタル印刷と環境フィルムのご紹介

■(株)武田産業

脱アルミのレトルトパウチを実現する、遮光PPフィルムのご紹介

■サエス・ゲッターズ S. p. A

エチレン吸着や各種バリア機能を水系コーティングで実現した、環境に優しいフィルムのご提案！

■東洋インキ (株)

環境調和型パッケージへの取り組みのご提案

■三井・デュポンポリケミカル (株)

Innovative packaging from polymer science

■日本テトラパック (株)

飲料以外でも広がる各種アセプティック容器及びレトルトできる紙容器テトラリカルトのご紹介

■エコリーン日本駐在事務所

地球環境に優しい軽量容器でお客様のブランドに差別化を

■藤森工業 (株)

コック付きパウチ：最後まで中身の鮮度をキープし、ガラス瓶の代替となるパウチのご提案

■(株) ウェーブブロックアドバンステクノロジー

特殊印刷 (see it to feel it, feel it to see it)、偽装判断技法包材のご提案

■東洋製罐グループホールディングス (株)

レンジパウチのご提案：加熱時に上昇する圧力を蒸気抜け機構で制御

■大日本印刷 (株)

『ヒトから考えるパッケージイノベーション』により開発した製品のご提案

## 5. おわりに

本年度も秋に「第2回 Next Package 2019 秋の陣」を開催します。募集は昨年同様7月ごろに当協会のホームページやメール等でご案内いたします。当協会では昨年以上に食品企業と包装材料メーカーを結ぶ、活気のある展示会を開催いたします。ふるってご参加ください。